

论文

鼓膜实验法测试薄膜基体界面结合强度的进展

任凤章 郑茂盛 刘平 贾淑果 JU Xihua 马战红 祝要民

摘要:

评述了用鼓膜实验方法测试薄膜与基体界面结合强度的现状和最新进展,分析了该方法针对圆孔、膜内无残余应力柔性膜试样和矩形孔或圆孔、膜内有残余应力试样(薄膜为柔性膜或刚性膜)所用解析解力学模型建立的薄膜力学性能假设前提条件、能量平衡思路和推导过程.介绍了用硅微技术制备Si基体试样的过程,指出了制备方法和解析解力学模型的特点及所存在的问题.给出了该实验方法的应用实例,指出了需要解决非硅基体的制样和薄膜塑性变形阶段力学模型等问题.

关键词:

Abstract:

Keywords:

收稿日期 1900-01-01 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期 2006-08-25

DOI:

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

扩展功能

本文信息

Supporting info

PDF(1479KB)

[HTML全文](1KB)

参考文献[PDF]

参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

本文作者相关文章

▶ 任凤章

▶ 郑茂盛

▶ 刘平

▶ 贾淑果

▶ JU Xihua

▶ 马战红

▶ 祝要民